

1

2

3

4

가공

ST

부호

내용

수정자

승인자

년 월 일

ST(기준)

ST(개선)

5

3

7

1

2

4

6

9.5

34.7

11

ø9.5

7

SPRING RING

1

SUS

부동태 처리

DSR00002-5/1 (R2001)

6

INSERT

1

MBsBD

Nickel Plate

DSR00051-5/1 (L7009)

5

COUPLING CAP

1

MBsBD

Gold Plate

DCU00005-5/1 (K2001)

4

INSULATOR

1

TEFLON

DAI00018-N/1 (HA010)

3

GASKET

1

SILICONE RUB

DGK00004-N/1 (G2001)

2

CONTACT

1

MBsBD

Gold Plate

DAC00031-5/1 (EA010)

1

BODY

1

MBsBD

Nickel Plate

DAD00009-5/1 (DA012)

대체가능재질

품번

품 명

수량

재 질

표면처리

비 고

공통공차

.* ±0.1

.*.* ±0.05

2000. 1. 4.

승인

검도

재도

작성부서

연 구 소

척도 3/1

단위 mm

중량

RF & MICROWAVE TECHNOLOGY

Tel : 82-32-347-8015

Fax : 82-32-347-8017

KJ COMTECH

KJ COMTECH CO.,LTD.

도명

SMAP-BNCJ

A4

도번

AD00013-7/1

K361-512-000

1

2

3

4

A

B